

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XCM406xxxxDR-G
標準質量: 9 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	1.212	シリコン	134600	7440-21-3
	-	砒素	<1	7440-38-2
リードパッド	2.248	ニッケル	249800	7440-02-0
	0.178	銀	19800	7440-22-4
	0.033	金	3600	7440-57-5
ダイアタッチ	0.025	エポキシ樹脂	2800	—
	0.022	溶融シリカ	2400	60676-86-0
ボンディングワイヤ	0.136	金	15100	7440-57-5
封止樹脂	4.631	溶融シリカ	514600	60676-86-0
	0.283	エポキシ樹脂	31400	—
	0.232	フェノール樹脂	25700	—

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせて頂いております。